

PEEL OUT STD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dosaggio minimo (1 millimetro massimo per ottenere un efficace effetto coprente)
- Rapido tempo d'essiccazione (Da 30 minuti a 2 ore a temperatura ambiente)
- Lungo tempo di stoccaggio circuiti prima della saldatura (Fino a 15 giorni)
- Lungo tempo di stoccaggio circuiti dopo la saldatura (Fino a 15 giorni)
- Perfetta visibilità dopo la saldatura
- Perfetta rimozione dopo la saldatura (Non lascia alcun residuo)
- Odore estremamente contenuto
- Max temperatura di utilizzo: 290 C° / 8 sec (dato riferito al prodotto completamente essiccato)

DESCRIZIONE

PEEL OUT STD è un prodotto a base di lattice di gomma naturale, a bassissima viscosità ed odore estremamente contenuto.

CAMPI D'APPLICAZIONE

E' utilizzata nel settore della saldatura dei circuiti stampati come prodotto interoperazionale, in particolare ove vi sia l'esigenza di proteggere temporaneamente delle piste, fori, piazzole, viti, contattiere od altro, dai prodotti disossidanti e dall'onda di stagno.

COMPATIBILITÀ

PEEL OUT STD non è corrosiva, ed è perfettamente compatibile con i materiali normalmente utilizzati.

NOTA: a contatto con il rame nudo tende a formare un leggero strato di passivazione.

PEEL OUT STD è fornito pronta per l'utilizzo, e può essere applicata nei seguenti modi:

1. Direttamente dal flacone dosatore
2. Siringa (Sia manuale, sia con dosatori automatici)
3. Serigrafia
4. Pennello

Per utilizzo con siringa (Tramite aspirazione), per serigrafia o con pennello, si consiglia l'uso del fustino da 5 kg.

Per applicazione tramite dispensatore automatico, le relative siringhe potranno essere riempite nei seguenti modi: manualmente, per mezzo del flacone dosatore o automaticamente, utilizzando gli appositi sistemi di riempimento, prelevando il prodotto dal fusto da 5 kg.

ESSICCAZIONE

Il tempo d'essiccazione è variabile in funzione delle condizioni ambientali. Rispettando la quantità di dosatura (**1 millimetro massimo**), i tempi indicativi sono i seguenti:

10-20 minuti per essiccazione in forno a 80°C.

Da 30 minuti a 2 ore per essiccazione naturale

STOCCAGGIO CIRCUITI PRIMA DELLA SALDATURA

PEEL OUT STD può rimanere polimerizzata sui circuiti prima della saldatura fino a 15 giorni.

STOCCAGGIO CIRCUITI DOPO LA SALDATURA

PEEL OUT STD può essere rimossa dal circuito fino a 15 giorni dopo la saldatura.

ASPORTAZIONE DEI RESIDUI

Dopo l'operazione di saldatura PEEL OUT è perfettamente visibile, in virtù del mantenimento del colore originale che la pone in netto contrasto con quello del circuito, e si asporta con estrema facilità con l'ausilio di una pressella, o per sfregamento manuale. Non lascia residui contaminanti, e non richiede la pulizia delle zone protette.

NOTA: si consiglia l'asportazione dei residui prima di un eventuale processo di lavaggio, per evitare intasamenti dell'impianto stesso.

MANIPOLAZIONE

Durante l'applicazione del prodotto non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. In caso di contatto con le mani, lavare con acqua fredda e sapone.

STOCCAGGIO

PEEL OUT STD deve essere immagazzinata ermeticamente a temperatura inferiore a 25° C.
Teme il gelo e non deve essere esposta ai raggi solari.

SCADENZA

Stoccaggio a temperatura ambiente (Inferiore a 25 °C.), 6 mesi.

Stoccaggio in frigo (+ 4 °C.), 12 mesi.

CONFEZIONAMENTO

PEEL OUT STD è disponibile nelle seguenti confezioni:

DESCRIZIONE
Flacone dosatore da 250 gr. con beccuccio e tappo (Confezioni da 25 flaconi)
Fustino da 5 kg.